

HC150SE匀胶机，采用高级PLC 全自动程序控制，转速精度高，稳定性好。可用于微电子、半导体、新能源、生物材料、纳米材料等领域高精度薄膜涂层的制备。

特点：

- 设计紧凑，可放置在手套箱内；
- HDPE内腔与不锈钢机身可分离，便于清洁和移动；
- 4.3英寸彩色触屏控制，简单易用，运行状态实时显示；
- 不锈钢外壳，美观耐腐蚀；
- 经CNC一体加工成型的HDPE内腔，耐腐蚀，易清洁；
- 内腔壁采用独特的凹面设计，有效防溅；
- 高级PLC全自动程序控制，可编程；
- 带真空度安全互锁检测功能；
- 可设置用户密码保护功能；
- 配置可调基座，方便调节水平；



技术参数：

- 适用晶元尺寸范围： $\varnothing 10\sim 150\text{mm}$
- 旋涂速度：100~12000rpm
- 转速分辨率：1rpm
- 旋涂加速度：100-30000rpm/s
- 最大旋涂时间：3000s
- 旋涂时间精度：0.1s
- 内腔直径212mm，内腔壁采用独特的凹面防溅设计；
- 具备单步快速旋涂和多步编程旋涂，可编程10组程序，每组程序10步；
- 电源输入：AC200-230V

设备外形尺寸： 长X宽X高：310X254X250mm

